

半导体可靠性试验，连接器压降测试

产品名称	半导体可靠性试验，连接器压降测试
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

半导体可靠性试验，连接器压降测试

高温试验

高温对产品有很多影响，如老化、氧化、化学变化、热扩散、电迁移、金属迁移、熔化、汽化变形等，通常周围环境每上升10℃，产品寿命就会减少到四分之一；当周围环境温度上升20℃，产品寿命就会减少一半，产品寿命遵循“10℃规则”，因而高温试验作为*常用的试验，用于元器件和整机的筛选、老化试验、寿命试验、加速寿命试验，同时在失效分析的验证上起重要作用。

测试范围：< 200℃ 测试参数：小于1m³ 16m³

高温试验低温试验

低温对产品有很多影响，如脆化、结冰、粘度增大、固化、机械强度的降低及物理性收缩等，低温试验用于考核产品在低温环境下贮存和使用的适应性，常用于产品在开发阶段的型式试验、元器件的筛选试验等。

测试范围：0℃ ~ -70℃ 测试参数：小于1m³ 1m³ 18.9m³ 测试范围：-40℃ ~ -70℃ 测试参数：无要求

交变湿热试验

交变湿热是模拟热带雨林的环境，确定产品和材料在温度变化，产品表面凝露时的使用和贮存的适应性。常用于寿命试验、评价试验和综合试验。

测试范围：温度：-70℃ ~ 180℃ 湿度：5%~98% 测试参数：小于1m³ 1m³ 18.9m³ 湿度 < 20% (只能用C34)

0的箱子，低温度 -40)

恒温恒湿试验

产品失效原因湿度的影响占40%以上，因此湿度试验在环境试验中是必不可少的。常用于寿命试验、评价试验和综合试验，同时在失效分析上起重要作用。尤其对含有树脂材料的产品在产品研发和质量评估时该试验是必须的。常做的双85指的就是温度85 ，湿度85%RH。

温度/湿度环境、温度驻留时间

测试范围：温度：-70 ~180

湿度：5%~98%

测试参数：小于1m3 1m3 18.9m3

湿度 < 20%

冷热冲击试验

温度冲击的试验目的是为了在较短的时间内确认产品特性的变化，以及由于构成元器件的异种材料热膨胀系数不同而造成的故障问题。这些变化可以通过将元器件迅速交替地暴露于超高温和超低温的试验环境中观察到。冷热冲击不同于环境模拟试验，它是通过冷热温度冲击发现常温状态下难以发现的潜在故障。

测试范围：温度: -75~220 转换时间， < 10秒测试参数：770*650*610mm